

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 2011年02月28日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

	NUBIC管理番号: <input type="text" value="2010000010"/> 整理番号 <input type="text" value="11369"/> 担当者 <input type="text" value="小森 幹雄"/>
表 題	<input type="text" value="薄板を用いた摩擦接合による板厚減少を抑制した突合せ接合"/>
技術分野	<input type="text" value="機械・加工"/> <input type="text" value="金属材料"/>
適用製品	<input type="text" value="薄板を使用する電気・電子機器筐体の組み立て、長尺(幅広)薄板の作成など"/>
目 的	<input type="text" value="従来、薄板の接合は重ね接合が主流であり、突合せ接合は困難とされているが、摩擦シーム接合によれば突合せ接合が可能であることが明らかになった。しかし、摩擦シーム接合では接合時に素材中に回転工具を押し込むため接合部の板厚が減少する。そこで、この板厚減少を抑制する方法を提供する。"/>
技術概要	<input type="text" value="アルミニウム合金やマグネシウム合金の厚さ1mm以下の薄板を用いて摩擦接合(摩擦シーム接合)による突合せ接合を行う際に、接合部の板厚減少を抑制するために、接合部に第3の板(突き合わせる素材と同一素材)を重ね合わせることで板厚の減少を抑制する。この際接合終了時には第3の素材の不要部分は容易に分離除去できるようにするための接合条件と第3の板の厚さとの関係について検討した。"/>

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。

(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)

各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時	<input type="text"/>		
(ふりがな) 氏 名	<input type="text"/>		
会社名	<input type="text"/>		
所 属	<input type="text"/>	役職	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		
連絡事項	<input type="text"/>		



【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@nihon-u.ac.jp